

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成29年11月30日(2017.11.30)

【公開番号】特開2017-191780(P2017-191780A)

【公開日】平成29年10月19日(2017.10.19)

【年通号数】公開・登録公報2017-040

【出願番号】特願2017-103540(P2017-103540)

【国際特許分類】

H 0 1 R 11/01 (2006.01)

H 0 1 R 43/00 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

H 0 1 B 1/00 (2006.01)

H 0 1 B 1/22 (2006.01)

H 0 1 B 5/16 (2006.01)

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

B 3 2 B 27/18 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 R 11/01 5 0 1 C

H 0 1 R 43/00 H

C 0 9 J 7/02 A

H 0 1 B 1/00 C

H 0 1 B 1/22 B

H 0 1 B 5/16

H 0 1 B 13/00 5 0 3 Z

B 3 2 B 27/18 J

【手続補正書】

【提出日】平成29年10月6日(2017.10.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ベースフィルムと、
上記ベースフィルム上に積層されたバインダー樹脂と、
上記バインダー樹脂に、所定の配列パターンで、規則的に分散配置された導電性粒子と
を備え、

複数の上記導電性粒子のうち、表面に痕が発生しているものが粒子数全体の30%以内
である導電性接着フィルム。

【請求項2】

上記導電性粒子は、表面が絶縁処理されたものである請求項1に記載の導電性接着フィルム。

【請求項3】

ベースフィルムと、
上記ベースフィルム上に積層されたバインダー樹脂と、
上記バインダー樹脂に、所定の配列パターンで、規則的に分散配置された導電性粒子と
を備え、

上記導電性粒子は、表面が金属であり、

上記導電性粒子は、表面の金属の一部が剥離しているものを含む導電性接着フィルム。

【請求項 4】

上記導電性粒子は、表面が金属でコートされたものである請求項 3 に記載の導電性接着フィルム。

【請求項 5】

上記表面に金属がコートされた導電性粒子は、めっき粒子である請求項 4 に記載の導電性接着フィルム。

【請求項 6】

上記導電性粒子は、上記表面が更に絶縁処理されたものである請求項 3 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の導電性接着フィルム。

【請求項 7】

ベースフィルムと、

上記ベースフィルム上に積層されたバインダー樹脂と、

上記バインダー樹脂に、所定の配列パターンで、規則的に分散配置された導電性粒子とを備え、

上記規則的に分散配置された導電性粒子は、上記導電性粒子が複数連結された凝集体を含み、

上記凝集体は、上記規則的に分散配置された導電性粒子数全体の 20% 以内である導電性接着フィルム。

【請求項 8】

上記凝集体の大きさが、上記導電性粒子の粒子径の 8 倍以下である請求項 7 に記載の導電性接着フィルム。

【請求項 9】

導電性粒子が配列された異方性導電フィルムによって複数並列された端子同士が接続された接続体において、

上記請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の異方性導電フィルムを用いている接続体。

【請求項 10】

導電性粒子が配列された異方性導電フィルムによって複数並列された端子同士が接続された接続体の製造方法において、

上記請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の異方性導電フィルムを用いた接続体の製造方法。

【請求項 11】

帯電が防止された基板上におけるスキージの移動によって、上記基板上に導電性粒子を所定の配列パターンに整列させ、

バインダー樹脂層が設けられたフィルムによって上記導電性粒子を転写することにより製造される導電性接着フィルムの製造方法であって、

上記スキージの基板上における移動に伴って、導電粒子に痕を発生させることを特徴とする導電性接着フィルムの製造方法。

【請求項 12】

上記導電性粒子を帯電させる請求項 11 に記載の導電性接着フィルムの製造方法。

【請求項 13】

上記スキージは、帯電が防止されている請求項 11 又は 12 に記載の導電性接着フィルムの製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

また、本発明に係る導電性接着フィルムは、ベースフィルムと、上記ベースフィルム上に積層されたバインダー樹脂と、上記バインダー樹脂に、所定の配列パターンで、規則的に分散配置された導電性粒子とを備え、上記導電性粒子は、表面が金属であり、上記導電性粒子は、表面の金属の一部が剥離しているものを含む。